高性能な非鉛系圧電セラミックスの開発

— スクリーン印刷法によるLi_{0.06}Na_{0.47}K_{0.47}NbO₃厚膜の作製—

加工技術課 二口友昭* 機械電子研究所 坂井雄一 富山県立大学 唐木智明 安達正利 藤井正

1. 緒 言

圧電セラミックスは、周波数フィルタやスピーカ 等の電子部品、および加速度センサやアクチュエー タ等電子機械部品として、多くの分野で利用されて いる。しかし、これらに利用される現状の圧電セラ ミックス材料は、鉛を含むため環境への悪影響が懸 念されており、新規な非鉛系の材料の開発が必要で ある。ここでは、環境に適合した自動車等への応用が 期待されるニオブ酸系の高温圧電セラミックスの開発研 究を実施した。大学では、水熱合成法による板状粒子 の作製とセラミックスの試作を行い、工技センターでは、 セラミックスの作製および組成や構造の分析とスクリーン 印刷による厚膜の作製行った。スクリーン印刷法は厚 み数10µmの厚膜パターンが容易に形成できるため、 MEMSデバイス用の強誘電体、圧電体厚膜としての 利用等が期待されている。また、この方法では基板 に固定されて膜が形成されるため、Bi層状化合物な どにおいて配向した膜が得られる。ここでは、 Li_{0.06}Na_{0.47}K_{0.47}NbO₃粉末を用いて作製したペースト をスクリーン印刷し焼成により形成される厚膜に ついて、作製条件および添加物と厚膜の微細構造お よび電気特性の関係をバルク焼結体と比較して検 討した

2. 実験結果

(1) 水熱法による板状(K,Na)NbO3 の作製

KOH,NaOH,Nb₂O₅の原材料と界面活性剤を用いて、 オートクレーブで、反応温度160~250℃、反応時間 2時間以上で水熱合成を行った。この段階で、厚み 約150nm、径が1.5µmの板状結晶が得られた。これを 450℃で熱処理することにより、ペロブスカイト型 の板状(K,Na)NbO₃になった。この水熱法と熱処理を 組み合わせる方法は、溶融塩を用いる従来法に比べ て、低コストかつ省エネで量産に適していると考え られる。今後この粉末を用いて配向性圧電セラミッ クスを作製する予定である。

(2) Li_{0.06}Na_{0.47}K_{0.47}NbO₃バルクセラミックスの特性
配向性圧電セラミックスを作製する前に、焼成条

*現 企画管理部

件や焼結助剤などを調べるために、通常の固相反応 法により合成されたLi_{0.06}Na_{0.47}K_{0.47}NbO₃粉末を用い てバルクセラミックスを作製した。図1は、焼成温 度と誘電損失の関係を示す。

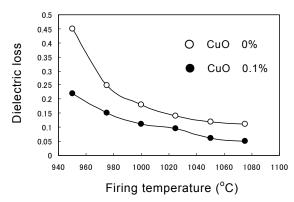


Fig.1. Dielectric loss of the $Li_{0.06}Na_{0.47}K_{0.47}NbO_3$ bulk ceramics

焼成温度の上昇に従って誘電損失が低下した。また CuOを0.1%添加するとで、さらに誘電損失が低下し、 焼成温度1175℃で、5%になった。このとき誘電率は 650であった。

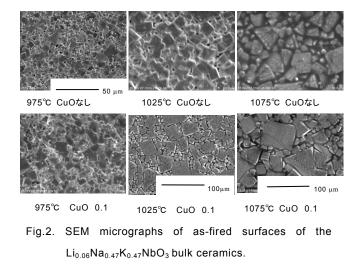
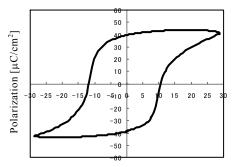
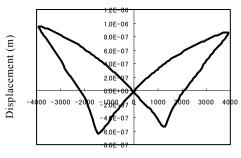


図2は、バルクセラミックス表面のSEM写真を示す。 焼成温度の上昇に従って、粒成長しているのが確認さ れた。CuOを添加した場合は、さらに粒成長が促進 されていた。また粒子形状はアルカリニオブ酸塩系に 特徴的な角状ものであった。



Electric Field [kV/cm]

Fig.3. P-E hysteresis loop of the Li_{0.06}Na_{0.47}K_{0.47}NbO₃ bulk ceramics with CuO 0.1wt% fired at 1075°C.



Applied voltage (V)

Fig.4. Displacement of the bulk ceramics with CuO 0.1wt% fired at 1075°C under the applied voltage of 4kV.

図3は、CuOを添加し1375℃で焼成したバルクセラ ミックスのP-Eヒステリシス曲線を示す。これより 比較的大きな残留分極Pr= 40µm/cm²が得られてい ることがわかった。図4は、4kVのバイポーラ電圧 を印加した時の変位の様子を示す。強誘電体の分極 反転に伴うバタフライカーブが得られた。最大変位 から求めた圧電定数は、d₃₃=224 pm/Vであった。 (3) Li_{0.06}Na_{0.47}K_{0.47}NbO₃厚膜の作製と特性

Li_{0.06}Na_{0.47}K_{0.47}NbO₃粉末にエチルセルロース系の ビヒクルを加え3本ロールで混練することにより厚 膜ペーストを作製した。基板には厚み200µmのY₂O₃ 安定化ZrO₂を用いた。この上にPtペーストをスクリ ーン印刷し1300℃60min焼成して下部電極を作製し たLi_{0.06}Na_{0.47}K_{0.47}NbO₃ペーストをスクリーン印刷後 乾燥させた後、所定温度で1hの焼成を行った。上部 電極はAgペーストをスクリーン印刷し、850℃10min の焼成により作製した。バルクセラミックスと同じ焼成 条件で厚膜焼成を行うとLi_{0.06}Na_{0.47}K_{0.47}NbO₃の蒸発と 分解が発生し、また基板との反応も起こった。種々検討 した結果、975℃程度までの焼成温度の低下が必要で あることがわかった。そこでCuOの更なる添加を検討した ところ添加量を2%まで増加すると低温焼成が可能で あることが明らかになった。

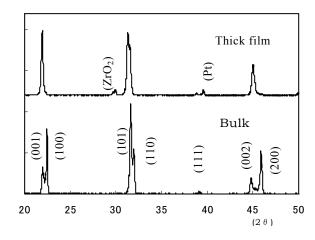


Fig.5. XRD patterns of the Li_{0.06}Na_{0.47}K_{0.47}NbO₃ bulk ceramics and thick film fired at 975°C

図5は975℃で焼成したバルクセラミックスと厚膜 のX線回折図を示す。厚膜のX線回折図には、正方 晶ペロブスカイト型化合物の他に基板のZrO2およ び電極のPtのピークが観測された。また、ペロブス カイト相は、厚膜においてはバルクセラミックに比 べて(001)に配向していた。

キーワード:圧電体、強誘電体、アルカリニオブ酸塩、厚膜、スクリーン印刷

Development of High Performance Lead-Free Piezoelectric Ceramics -Preparation of Li_{0.06}Na_{0.47}K_{0.47}NbO₃ thick films by screen printing-

Tomoaki FUTAKUCHI and Yuichi SAKAI (Toyama Industrial Technology Center) Tomoaki KARAKI, Masatoshi ADACHI and Tadashi Fujii (Toyama Prefectural University)

 $Li_{0.06}Na_{0.47}K_{0.47}NbO_3$ thick films were prepared by screen printing and firing using Pt bottom electrodes and ZrO₂ substrates. Screen-printable pastes were prepared by kneading the $Li_{0.06}Na_{0.47}K_{0.47}NbO_3$ powder in a three-roll mill with an organic vehicle. The microstructures and electric properties were examined. The (001) preferred oriented structure was obtained for the thick film prepared by screen printing and firing.